

ニュースガイド No. 11179

<日本特許・実用新案明細書収録セット>

ホームページ公開中！ <http://www.itdc-patent.com>

*最新の特許情報が満載！

無電解貴金属メッキ方法と工程

[登録・公開編]平成28年(1年間) 70点

	(税込価格)	(本体価格)
全文PDF CD-ROM版(抄録版付)	¥21,600-	¥20,000-
全文紙収録 B5製本版	¥21,600-	¥20,000-
CD-ROM版・B5製本版 一括購入	¥32,400-	¥30,000-

既刊関連セットのご案内

No.	公開特許	既刊関連セットのご案内	平.	点	(本体価格)
No,11077	公開特許	無電解貴金属メッキ方法と工程	平.27	69点	¥20,000
No,11002	"	"	平.26	70点	¥20,000
No,10891	"	"	平.25	70点	¥20,000
No,10830	"	"	平.24	70点	¥20,000
No,10700	"	"	平.23	59点	¥18,000
No,10579	"	"	平.22	59点	¥18,000
No,10493B	"	"	平.21	60点	¥18,000
No,10493A	"	"	平.20	60点	¥18,000
No,11126	登録・公開	貴金属メッキ方法と工程	平.28	100点	¥24,000
No,11045	"	"	平.27	70点	¥20,000
No,11021	"	"	平.26	68点	¥20,000
No,10875	"	"	平.25	67点	¥20,000
No,10199	公開特許	無電解スズ合金メッキ方法と浴の組成	平.15-平.19	62点	¥24,885
No,9998	"	スズ合金メッキ方法と浴の組成	平.13-平.17	100点	¥29,600
No,9189	"	"	平.10-平.12	68点	¥24,800
No,9088	"	硫酸銅メッキ方法と浴の組成	平.5-平.12	71点	¥27,700
No,9086	"	銅めっき装置の構造と付属装置	平.5-平.12	70点	¥27,400
No,9087	"	プリント基板のメッキ処理装置	平.8-平.12	71点	¥27,700
No,8929	"	メッキ前処理剤の組成と前処理方法	平.5-平.11	81点	¥31,600

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、EメールまたはFAX・郵便にてお送りください。

(メール宛先: kokusai@itdc-patent.com)

お電話でも承ります)

[CD-ROM版はPDFファイルにしおりリンク機能、B5製本版はB5サイズ・目次製本済みです。]

2～3日中に請求書同封の上お送り致します。]

お 申 込 書

会社名	ご注文内容	
	ニュースガイドNo.	
	CD-ROM版 or B5製本版 or 一括購入	
所属部署名	題名	
		合計 ¥
担当者名	E-mail:	
	TEL:	FAX:
住所:〒		

料金には別途送料がかかります。

無電解貴金属メッキ方法と工程

No.11179

[登録・公開編] 平成28年(1年間) 70点

CD-ROM版 ¥21,600 B5製本版 ¥21,600 (全て税込価格)

(CD-ROM版・B5製本版 一括購入 ¥32,400)

- | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|
| 1 還元型無電解銀めっき液及び還元型無電解銀めっき方法 | 上村工業株式会社 | 30 無電解めっき物の製造方法 | 出光興産株式会社 |
| 2 ラジウム合金めっきの前処理用活性化液 | 奥野製薬工業株式会社 | 導電粒子、絶縁被覆導電粒子、異方導電性接着剤、接続構造体及び導電粒子の製造方法 | 日立化成株式会社 |
| 3 導電用銀被覆硝子粉及びその製造方法、並びに導電性ペースト | DOWAエレクトロニクス株式会社 | 32 端子及びコネクタ | 矢崎総業株式会社 |
| 4 有機ケイ素化合物および該有機ケイ素化合物を使用する無電解めっきの前処理方法 | 株式会社ADEKA | 33 無電解白金メッキ液 | 日本エレクトロプレイティング・エンジニアーズ株式会社 |
| 5 無電解めっきの前処理皮膜形成用組成物 | 地方独立行政法人 大阪市立工業研究所 | 34 ウェハ及びウェハの製造方法 | JX金属株式会社 |
| 6 無電解めっき前処理方法 | 株式会社ADEKA | 35 摺動接点及びスイッチ | 矢崎総業株式会社 |
| 7 電子デバイスを製造する方法 | ラム リサーチ コーポレーション | 36 圧着端子 | 矢崎総業株式会社 |
| 8 薄膜製造装置、薄膜製造方法、液滴吐出ヘッドの製造方法 | 株式会社リコー | 37 粘着剤付きテープ貼り付け装置 | JX金属株式会社 |
| 9 インサイチュ還元によるポーラスシリコン領域の金属化及び燃料電池への応用 | コミサリア ア レネルジー アトミック エ オ ゼネルジー アルテルナティブ | 38 生体適合性積層体及び生体適合性電子部品 | 学校法人関東学院 |
| 10 表面被覆方法、並びに半導体装置、及び実装回路基板 | 富士通株式会社 | 39 無電解白金めっき液及びそれを用いて得られた白金皮膜 | 日本高純度化学株式会社 |
| 11 電磁波透過用金属被膜の製造方法 | 三恵技研工業株式会社 | 40 無電解白金めっき浴 | 石福金属興業株式会社 |
| 12 メタライゼーション処理、混合物、および、電子デバイス | ラム リサーチ コーポレーション | 41 金めっき用ノンシアン金塩の新規製造方法 | 小島化学薬品株式会社 |
| 13 導電性微粒子及びそれを含む異方性導電材料 | 株式会社日本触媒 | 42 銀被覆粒子及びその製造方法 | 三菱マテリアル電子化成株式会社 |
| 14 銀コート銅粉及びそれを用いた銅ペースト、導電性塗料、導電性シート、並びに銀コート銅粉の製造方法 | 住友金属鉱山株式会社 | 43 プラスチゾルコーティングされたメッキ治具のための金属化防止剤 | ローム アンド ハース エレクトロニック マテリアルズ エルエルシー |
| 15 無電解パラジウムめっき浴組成物 | アテック・ドイチユラント・ゲゼルシャフト・ミット・ベシユレンクテル・ハフツング | 44 導電性粒子、導電材料及び接続構造体 | 積水化学工業株式会社 |
| 16 黒鉛への銀の無電解めっき | ヘンケル アイビー アンド ホールディング ゲゼルシャフト ミット ベシユレン... | 45 金めっき用ノンシアン金塩の新規製造方法 | 小島化学薬品株式会社 |
| 17 金属めっき方法 | グリーンケム株式会社 | 46 電気素子及びコネクタ | 矢崎総業株式会社 |
| 18 銅メタライズ配線セラミック基板及びその製造方法 | ニッコー株式会社 | 47 電気素子及びコネクタ | 矢崎総業株式会社 |
| 19 誘電体層の無電解メッキ用活性化溶液 | ラム リサーチ コーポレーション | 48 銀被覆樹脂粒子及びその製造方法並びにそれを用いた導電性ペースト | 三菱マテリアル電子化成株式会社 |
| 20 被覆体及び電子部品 | TDK株式会社 | 49 銀被覆銅粉およびその製造方法 | DOWAエレクトロニクス株式会社 |
| 21 表面処理装置 | 上村工業株式会社 | 50 触媒の製造方法及び製造装置 | トヨタ自動車株式会社 |
| 22 ラジウム合金めっきの前処理用活性化液 | 奥野製薬工業株式会社 | 51 微細構造へのめっき方法 | 国立大学法人福井大学 |
| 23 無電解白金めっき液、その製造方法、及び白金皮膜の形成方法 | メタローテクノロジーズジャパン株式会社 | 52 樹枝状銀コート銅粉の製造方法 | 住友金属鉱山株式会社 |
| 24 非導電性基板上への銀層の沈着 | シー・アール・バード・インコーポレーテッド | 53 無電解めっきの下地皮膜形成用組成物 | 奥野製薬工業株式会社 |
| 25 無電解白金メッキ液 | 日本エレクトロプレイティング・エンジニアーズ株式会社 | 54 半導体装置の製造方法 | 富士電機株式会社 |
| 26 還元型無電解金めっき液及び当該めっき液を用いた無電解金めっき方法 | 小島化学薬品株式会社 | 55 導電膜形成用組成物及びこれを用いる導電膜の製造方法 | 富士フィルム株式会社 |
| 27 被覆体及び電子部品 | TDK株式会社 | 無電解Ni/Auめっき皮膜の形成方法及びその形成方法で得られた無電解Ni/Auめっき皮膜 | 学校法人関東学院 |
| 28 めっき物 | JX金属株式会社 | 57 無電解白金めっき液用安定剤の選定方法及び無電解白金めっき液 | 学校法人関東学院 |
| 29 ノーシアン無電解金めっき浴 | 学校法人関東学院 | | |

以下13点省略